



BUSINESS REPORT 2016

FUJIMI

FUJIMI INCORPORATED

株式会社フジインコーポレーテッド

社長あいさつ



平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2016年3月期の当社グループを取り巻く環境は、米国では景気回復基調が続き、欧州、日本など先進国は金融緩和政策などが景気を下支えしましたが、中国をはじめとする新興国は経済成長の鈍化が鮮明となりました。また、世界半導体市場は、これまで成長を牽引してきた中国スマートフォン市場の減速により、第2四半期連結会計期間以降、前年同期を下回る状況となりました。

こうした状況下、当社グループでは一丸となって売上拡大とコスト削減に努めましたが、当連結会計年度の業績は、売上高31,755百万円（前期比3.2%減）、営業利益は売上減少に加え販売費及び一般管理費の増加により3,302百万円（前期比20.0%減）、経常利益3,342百万円（前期比27.3%減）、親会社株主に帰属する当期純利益2,346百万円（前期比36.5%減）となりました。

2016年3月期のトピックスとしましては、CMP向け製品の売上高が10,980百万円となり、過去最高を記録しました。これは、アジア市場における最先端ロジックデバイス向け製品およびメモリデバイス向け製品の販売が好調に推移したことによるものです。現在、フジミ台湾において、次世代向け製品の製

造ライン拡張を進めており、さらなる売上の伸長を目指してまいります。また、北米においては、米国インテル社より2年連続となるプリファード・クオリティー・サプライヤー（PQS）賞を受賞しました。北米においても最先端ロジックデバイス向け製品で高い評価をいただいております、さらなる売上拡大に取り組んでまいります。

その他、新たな取組みとしましては、昨年4月の先端技術研究所の設置に続き、11月にはコーポレート・ベンチャー・キャピタル（CVC）ファンドを設立しました。すでに数多くのベンチャー企業と接触を行い、中長期的な視点に立って独自技術を保有するベンチャー企業への具体的な投資の検討を進めております。今後、当社コア技術とのシナジーが期待できる企業への投資を通じて、新規事業機会の探索活動を加速してまいります。

最後になりますが、現在、第6次となる中長期経営計画を策定中です。本来であれば、当期は2009年6月に策定した中長期経営計画の第3段階にあたりますが、計画の前提となる市場環境および世界経済環境が大きく変化したことから、次なる成長を遂げるために計画の見直しを行っているものです。これまで築き上げた強固な財務基盤を背景として、成長のための既存・新規分野および当社コア技術の強化と新技術獲得へ向けた投資を積極的に行うと同時に株主の皆様への還元強化、CSR活動にも力を注いでまいります。具体的な取組みでは、株主の皆様への還元強化策として、目標とする連結配当性向をこれまでの30%から2019年3月期を目途に50%まで高めることとしました。

皆様のご厚情に感謝するとともに、これまでと変わらぬご理解とご支援をいただきますようお願い申し上げます。

2016年7月
代表取締役社長

関 敬史

プロフィール

当社の創業以来蓄積されたノウハウと研究開発力から生まれた当社製品の数々は、シリコンウェハーに代表される半導体基板の鏡面研磨、半導体チップの多層配線に必要なCMP（化学的機械的平坦化）、コンピュータ用ハードディスクの研磨など高精度な表面加工が求められる先端産業に欠かせぬものとなっております。

最近では、LED・ディスプレイ・パワーエレクトロニクス用部品等の硬脆材の表面加工分野やその他さまざまな表面加工のニーズに独自のソリューションで応える取組みを積極的に進めております。また、溶射技術や装置に最適な溶射材の開発・商品化で新分野を開拓しております。

目次

社長あいさつ	1
経営方針	3
研究開発活動	5
暮らしの中のフジミ	9
製造工程の中のフジミ	11
経営指標	15
連結貸借対照表	19
連結損益計算書	21
連結包括利益計算書	21
連結キャッシュ・フロー計算書	22
会社データ	23
株式情報	24
グローバル展開	25

Message from the President

During the fiscal year ended March 31, 2016, the Fujimi Group's operating environment was influenced by several factors including the ongoing economic recovery in the United States, monetary easing measures that supported the economic activity in Europe, Japan and other advanced countries, and the economic slowdown in China and other emerging markets. The second half decline of the global semiconductor market, which dropped below the previous year's levels, is due to the slowdown of China's smartphone market.

Under these circumstances, the Group worked together and strived to increase sales and reduce costs, however, despite these efforts the year over year net sales fell 3.2% to ¥31,755 million. Due to the decrease in sales, combined with higher selling and general administrative expenses, the operating income decreased 20.0%, to ¥3,302 million; ordinary income fell 27.3%, to ¥3,342 million, and net income attributable to owners of parent declined 36.5%, to ¥2,346 million.

Highlights for the year ended March 31, 2016, include the highest sales to date of products for chemical mechanical planarization (CMP), at ¥10,980 million. The basis for the record sales were favorable sales in Asia of products for leading-edge logic and memory devices. Fujimi Taiwan is currently expanding its next-generation product lineup focusing on further boosting the related sales. Also, in America we received for the second consecutive year, Intel Corporation's Preferred Quality Supplier award and we are working to increase sales of products for leading-edge logic devices.

In April 2015 we established the Advanced Technology

Research Center and, in conjunction with that, in November we set up a corporate venture capital fund. We are already in contact with numerous venture companies and, taking a medium to long-term viewpoint, we are considering specific investments in venture companies that possess proprietary technologies. Going forward, we will accelerate our search for new business opportunities in areas that promise synergy with our core technologies.

We are in the process of formulating our sixth Mid-Long Term Management Plan. Although we would normally have been operating in the third phase of the Mid-Long Term Management Plan formulated in June 2009, we have decided to revise the plan due to major global economic and market changes that have occurred since the original plans were drafted. Based on the robust financial foundation that we have created to date, in the interest of growth, we will invest proactively in existing and new fields, as well as strengthen our core technologies and acquire new technologies. At the same time, we will augment shareholder returns as well as continue with activities focused on Corporate Social Responsibility. As one specific measure to boost shareholder returns, we are raising our consolidated dividend ratio target from 30% to 50% to be accomplished by the year ending March 31, 2019.

We are grateful for your patronage and ask for your continued understanding and support.

July 2016

Keishi Seki, President

Profile

Drawing on the know-how and R&D capabilities the company has accumulated since its founding, we have developed numerous products essential for leading-edge industries with high-precision polishing needs, including mirror polishing of semiconductor substrates like silicon wafers, CMP (Chemical Mechanical Planarization) required for the multilayer wiring of semiconductor chips, and computer hard disk polishing.

Recently, we have been actively pursuing unique solutions to address surface finishing needs for hard and brittle materials, such as parts used in LEDs, displays, and power electronics, as well as other types of materials. We have also been exploring new fields through the development and commercialization of optimal thermal spray materials for thermal spray technologies and devices.

Contents

Message from the President	2
Management Objectives	4
Research and Development Activities	6
Fujimi's Products and Technology in Everyday Life	9
Fujimi's Products in Manufacturing Process	11
Selected Financial Data	15
Consolidated Balance Sheet	19
Consolidated Statement of Income	21
Statement of Consolidated Comprehensive Income	21
Consolidated Statement of Cash Flows	22
Corporate Data	23
Stock Information	24
Global Expansion	25

経営方針

はじめに

当社は「パウダーテクノロジー」を事業領域の基本として、コア技術を高め先端技術をリードすることにより、お客様の満足度を高め信頼を勝ち得てまいりました。「企業使命」「経営姿勢」および「行動規範」から構成される企業理念を掲げ、創業以来一貫して製品の品質と安定供給に努めております。

当社が創業以来持ち続ける「ものづくり」の姿勢、お客様に高品質な製品を安定提供するための努力は変わることが

ありません。ますます多様化するお客様のニーズや技術水準の高度化に対して、迅速かつ確に対応し、「顧客満足度を高める質の創造と提供」を目指した体制づくりに取り組むことにより、企業価値を高めてまいります。

また、コーポレートスローガン「技術を磨き、心をつなぐ」はあらゆるステークホルダーの期待に応え、世界の人々の生活を豊かにしたいという当社の願いを表すものとして引き続き掲げてまいります。

企業理念

企業使命

高度産業社会の期待に新技術で応え、地球に優しく、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献します。

経営姿勢

- ・お客様の視点に立って独自のソリューションを提案します。
- ・経営環境の変化に対応するため、何事にも積極果敢にチャレンジし、変革し続けます。
- ・技術と経営の質を高め、法令を遵守し、ステークホルダーの信頼に応えます。

行動規範

- ・お客様の満足を常に考え行動します。
- ・問題の本質を追求し、迅速且つ確実に解決します。
- ・夢の実現に向け、熱意・誠意・創意をもってチャレンジします。
- ・ひとりひとりのアイデアを尊重し、それをカタチにします。
- ・良き市民・良き国際人として高い倫理観をもって行動します。

企業ビジョン

事業アイデンティティ

パウダー&サーフェイス分野で世界最高技術を提供し、理想とする「エクセレントカンパニー」を目指します。

私たちが理想とする「エクセレントカンパニー」とは、業績が優れているだけでなく次の3つを実現する会社です。

- ・変化に的確に対応し、未来に向けて持続的に成長する。
- ・企業理念・ビジョンの実現に向け、一人ひとりが熱意をもって、生き活きと仕事に取り組む。
- ・循環型社会の一員として環境負荷の低減に貢献する。

企業文化ビジョン

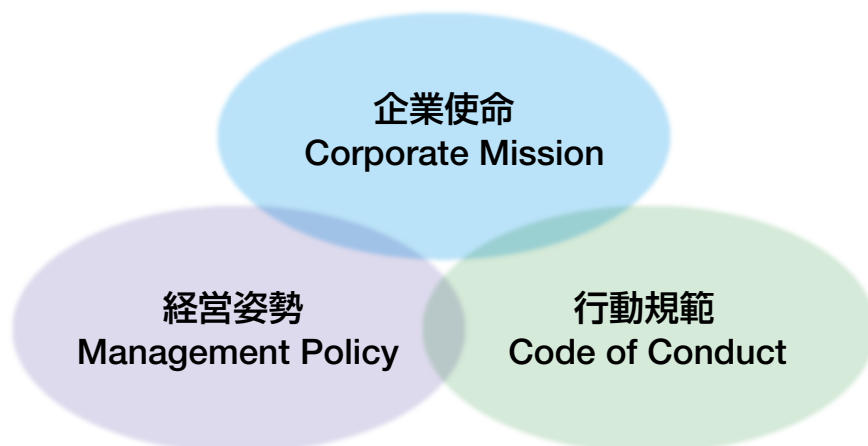
強く、やさしく、面白い会社を目指します。

- ・自由闊達で切磋琢磨する風土をつくります。(強く)
- ・仲間を大切に、助け合い、感謝します。(やさしく)
- ・夢をいだき、夢がかなう職場をつくります。(面白い)

事業構造ビジョン

既存事業の強化を図りつつ新規分野に積極果敢にチャレンジし、半導体関連分野(シリコン・CMP)と非半導体関連分野の安定した事業バランスの構築を目指します。

企業理念 Corporate Philosophy



Management Objectives

Introduction

Fujimi has endeavored to earn the trust of and further satisfy its customers by advancing its leading-edge core technologies, centered on its base in powder technologies. In line with our corporate philosophy, which comprises our Corporate Mission, Management Policy and Code of Conduct, we continue in our efforts to consistently deliver a stable supply of high-quality products—a cornerstone of our business.

Since our establishment, we have worked persistently to provide our customers with a stable supply of high-quality

products, a manufacturing approach from which we have never wavered. We aim to increase corporate value by swiftly and accurately meeting the diverse needs of customers with sophisticated technologies. To enhance corporate value, we are conducting organizational initiatives designed to create and deliver quality that will satisfy our customers.

To meet all our expectations, our corporate slogan, “polishing our technologies and bringing people together,” which expresses our desire to provide the people of the world with a rich lifestyle, will remain same.

Corporate Philosophy

Corporate Mission

Our mission is to develop new, innovative technologies and applications with a commitment to environmental sustainability, thereby enabling the advancement of technology for the betterment of humanity.

Management Policy

- We adopt the customer’s point of view to create solutions that meet the customer’s needs and expectations.
- We excel in the ever changing business environment through innovation and continuous improvement.
- We adhere to rules and regulations and operate ethically, thereby strengthening our stakeholders’ confidence and trust.

Code of Conduct

- We act with customer satisfaction in mind.
- We strive to identify the cause of an obstacle and to resolve it quickly.
- We challenge ourselves to succeed with passion, sincerity and creativity.
- We respect each person’s ideas.
- We conduct ourselves with pride, honesty and integrity.

Corporate Vision

Business Identity

We offer the world’s highest level of technology in the powder and surface fields, and aim to be an “excellent company.”

Being an “excellent company” means not only having excellent results. It also includes the following.

- Respond to change precisely, and grow continuously.
- Each person works eagerly to achieve corporate philosophy and vision.
- Contribute to decreasing environmental impact as a member of a recycling-based society.

Corporate Cultural Vision

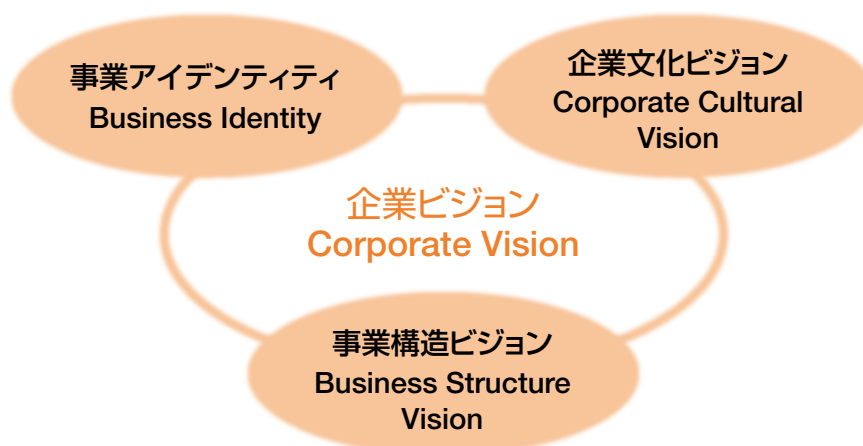
Fujimi will be a strong, kind and exciting company.

- Arrange to work hard with a free and broad mind. (Strong)
- Be nice, cooperative and appreciative to colleagues. (Kind)
- Have a future plan, and form individual working groups to achieve such plan. (Exciting)

Business Structure Vision

Fujimi will strengthen its existing businesses while aggressively taking on challenges in new fields. We will construct a stable business that is balanced between the semiconductor (Silicon and CMP) and non-semiconductor fields.

企業ビジョンの構成 Structure of the Corporate Vision



研究開発活動

当社は、超精密研磨のリーディングカンパニーとして常に先端電子産業を支えるべく、シリコンウェハー、半導体デバイス、ハードディスクをはじめとする、さまざまな電子部品の研磨・研削材の開発に取り組んでいます。

また、溶射材の開発、当社成長のコア技術となる基盤技術開発機能の充実、技術に基づいた新規事業・新規テーマの調査探索機能の強化に努めております。

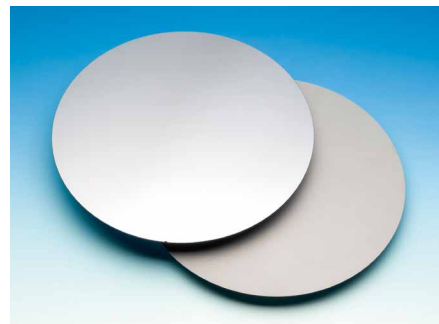
シリコンウェハー

300mmシリコンウェハーの需要拡大、デザインルールの微細化に伴い、超精密研磨の要件である、①高平坦化、②高平滑化、③無欠陥化、④汚染低減、⑤生産性向上への要求はますます強くなっております。

高平坦化や生産性向上が求められている、ラッピング材やシリコンウェハー切断用研磨材では、加工力、加工精度および加工歩留まり向上を共に満足する製品の検討を進めております。

一次研磨工程用スラリーとしては、ウェハー中心部から最外周部まで超平坦に加工できる差別化製品から、高速研磨型やリサイクル性付与型等お客様の生産性向上につながる製品までを、また、最終仕上げ研磨工程用スラリーでは、配線間隔が10nm台のウェハー研磨用として研磨後表面のナノ欠陥を激減し原子レベルの平滑性を実現するポリシング材の開発を、砥粒・添加剤設計、配合技術を応用しながら取り組んでおります。

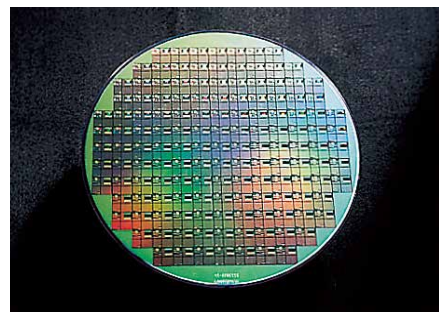
さらには、近年次世代パワーデバイスとしてSiCやGaN系の半導体が注目されております。これら難加工基板用研磨材の研究開発も進めており、高速・高面質となる新たな製品・プロセス開発に取り組んでおります。



半導体デバイス

先端の半導体デバイスの微細化が進展し、テクノロジーノード14nm/16nmの量産本格化、10nmの量産立ち上げおよび7nm以細のデバイスの研究開発が進んでいます。微細化の進展に伴い、Fin FETと呼ばれる新しい3次元構造のトランジスタが開発、量産されています。また、3次元に積層したNANDフラッシュメモリの開発、量産化や高密度化を目的に3次元にLSIを積層する、スルーシリコンビア(TSV)技術の開発も進んでいます。これらの新トランジスタや新構造の形成においてもCMPプロセスが適用されており、その範囲がますます広がっております。

当社では、従来の多結晶シリコン薄膜用やCu配線用にポリシング材を開発していますが、上記のようなCMPプロセスの用途拡大に合わせ、Fin FETトランジスタ用、TSV用などにおける新たな研磨対象となる材料や構造に適用できるポリシング材の開発も始めています。微細化、高密度化とともに高度化するお客様の要求にお応えするため、当社では最先端の研磨装置、評価装置を活用すると同時に、当社の砥粒技術、ケミカル技術などを活かした研究開発を行っております。



ハードディスク

増大していくデジタルデータの保存要求量に対応するために、次世代ハードディスクの開発が加速されています。現在、ハードディスク基板はナノレベルの欠陥が問題とされており、欠陥数および欠陥サイズの低減要求はさらに厳しくなっております。本要求に応えるべく、お客様と一体となった活動により新製品の開発を推進しております。



Research and Development Activities

As the leading name in synthetic precision abrasives, Fujimi supports the advanced electronic industry through its development of polishing and abrasive compounds for various electronic components, such as silicon wafers, semiconductor devices and hard disks. Also, we are seeking to enhance the development of thermal spray materials and the fundamental technology development function, which is the core technology for our growth. We are working to strengthen our research and seeking functions on technology-based new business and topics.

Silicon Wafers

As there is an increase of demand for 300mm silicon wafers in the market, as well as a further shrinking of design rules, requirements of super precise polishing for 1) high flatness, 2) low roughness, 3) defect free, 4) metal contamination free and 5) productivity improvement are getting stronger and stronger.

For the application of silicon lapping and slicing abrasives, for which high flatness and high productivity are needed, we are proceeding with activities to satisfy the cutting rate, quality and yield for customers.

For the application of silicon stock polishing slurry, we are exclusively developing new products, not only to produce a super flat silicon wafer from the wafer center to the furthest area on the periphery, but also to enhance the productivity for customers through a high stock removal rate and longer recyclable slurry. And for the application of the final polishing slurry to meet a 10nm level node, we are also developing new products that can reduce nanometer-sized defects drastically and improve the atomic level roughness after polishing based on abrasive/additive design and formulation technology.

Furthermore, SiC and GaN semiconductors have recently been focused on as next-generation power devices. We are proceeding with R&D activities on the slurry for such a hard material and are working to develop a new product/process for a high removal rate with a high surface quality.

Semiconductor Devices

The shrinking of leading-edge semiconductor devices is progressing as the mass production of 14nm and 16nm technology nodes are now accelerating the mass production of 10nm devices is now starting, and research and development is moving forward towards 7nm and smaller devices. Alongside the shrinking trend, a new kind of transistor with a 3D structure, known as a FinFET, has been developed and taken to production. In addition, newly developed 3D NAND flash memories have already moved into mass production, and the development of Through Silicon Via (TSV) technology that laminates LSIs in 3 dimensions for higher densification is underway. We are exploring the application of CMP processing to forming these new transistors and new architectures with the strong prospect of expanding its scope.

We have already developed slurries for polycrystal silicon films and Cu wiring, but to expand the use of CMP processing as aforementioned, we have launched research into slurries that can be used with new materials and structures for FinFET transistors, TSV and so forth. We are employing state-of-the-art polishing and evaluation equipment, and applying proprietary polishing and chemical technologies to research and development operations in order to meet customer requirements for higher levels of shrinking densification and sophistication.

Hard Disks

The development of next generation hard disks has been accelerated for the required storage of increasing digital data. Today, the requirements for fewer and smaller defects are getting severer than ever, as nanometer-level defects are considered problems for the hard disk substrates. To meet these requirements, we have been driving new product developments through activities together with our customers.

機能材

プラスチック、ガラス、セラミックなど多種多様な表面に適した研磨材および原材料となる微粒子の開発に取り組んでおります。お客様のご要求を的確に捉え、当社のコア技術を活用してお客様にご満足いただける製品の開発を推進しております。

新規事業

半導体、ハードディスク用途など既存事業用途以外の新規用途(例:LED、ディスプレイ、モバイル用途など)で用いられる、金属、セラミック、樹脂などの多種多様な材質、またさまざまな形状に適した一般工業用部品の研磨材等の開発に取り組んでおります。新規の用途では、研磨材のみならず、用途に応じた装置や周辺消耗材の推奨も含めた、加工プロセスの開発・提供も必要とされております。世界のさまざまな業界のお客様から寄せられる表面創成ウォンツに、トータルソリューションでお応えしてまいります。



さまざまな産業



さまざまな課題



さまざまな加工対象



溶射材

省資源化、高効率化要求が高まっている現代社会において、航空機、半導体、一般産業機械など多岐にわたり高機能皮膜への要求は高まってきており、溶射皮膜の用途拡大が期待されております。近年の溶射プロセスでも、高効率化、高品質化へ向け、低温化、微粉化をキーワードとした新技術が注目を集めております。これら市場の期待に応えるべく、複合造粒技術やスラリー化技術などを活かした最適な溶射材の開発に重点を置き推進してまいります。



先端技術研究所

先端技術研究所は、1)既存のコア技術の深耕・強化、2)当社の技術と親和性のある分野での新規事業の創出、3)当社とシナジーを有し、基盤技術強化やその補完に役立つ有望な技術を保有するベンチャー企業への投資やM&A、の3つを遂行するために設立され、1年が経過しました。この間、展示会を利用してコア技術を社外発信する活動や、社外研究機関との連携活動を活発化し、“パウダー&サーフェイス”分野での新規事業に結びつくテーマ探索に努めてまいりました。それらの活動の結果、現在、非半導体分野での興味深い幾つかの新規研究開発テーマで可能性検証に至っております。さらに2015年11月には、ベンチャーキャピタル・ファンドを設立し、上記観点での有望なベンチャー企業の発掘を行っております。

本年もこれらの活動を推進し、新規事業の創出に努めてまいります。



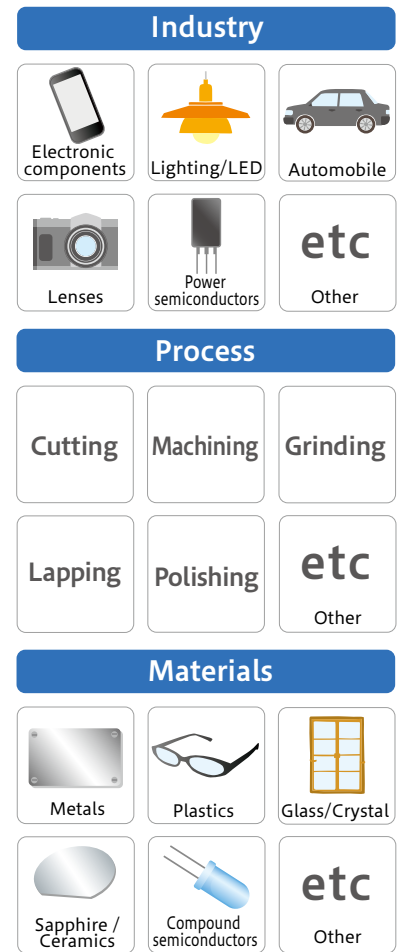
Specialty Materials

We have been developing polishing agents and microparticles for raw materials of the polishing agents suitable for various surfaces, such as plastic, glass and ceramic. To grasp customer's requirements accurately, we promote the development of products that can satisfy customers by utilizing our core technologies.

New Business

We are developing abrasives and other products for a wide variety of industrial components made of metal, ceramic and resin for new applications (e.g., LEDs, displays, mobile device, etc.) other than semiconductor, hard disk and other applications covered by existing business.

To speak to new applications, on top of abrasive products, development and provision of total manufacturing process are also necessary along with the recommendation of application-specific equipment and consumables. We will continue to serve the new surfacing requests of customers from all walks of industry and location by providing total solutions.



Thermal Spray Materials

In today's world of increasing demand for resource conservation and higher efficiency, there is a growing need for highly functional films across a wide range of products, such as aircrafts, semiconductors and general industrial equipment; thus, broader use of thermal spray films is expected. In recent years, attention has turned to new technologies where the keywords are "lower temperatures" and "micronization," as means for enhancing the efficiency and quality of thermal spray processing. In a move to meet these market expectations, we are stepping up our development of appropriate thermal spray materials by applying our compounding, granulation and slurring technologies.

Advanced Technology Research Center

One year has passed since we opened the Advanced Technology Research Center to achieve the following three tasks: (1) Expand and improve existing core technologies; (2) Create new technologies and businesses in the fields where our technologies can prove useful; and (3) Conduct M&A and investments in venture businesses that have synergy with us and that own promising technologies that can strengthen and enhance our core technologies. During the first year, we strove to explore themes that can connect to new businesses in the powder and surface fields by promoting our core technologies through exhibitions and actively collaborating with external research institutions. These activities have led us to some interesting research and development themes in non-semiconductor fields, the potential of which is now under validation. In November, we established a venture capital fund that explores promising venture businesses from the aforementioned prospectives.

This year, we will continue to promote these activities and make an effort to have new businesses.

暮らしの中のフジミ

Fujimi's Products and Technology in Everyday Life

フジミの製品は、生活の中のさまざまな物に使われています。
Fujimi's products are used for various items that people see and use in everyday life.



飛行機 Aircraft

ココにも



フラップ・スラット
レールに溶射材が
使われています。

Thermal Spray materials
are used for flap-slat
rails.



ココにも FUJIMI 鉄道 Railroads

車両の中の IC チップ製造
過程で FO、GLANZOX、
PLANERLITE 等が使われ
ています。

FO, GLANZOX and
PLANERLITE are used for
manufacturing process of
IC chips placed in rolling
stock.



ココにも FUJIMI 信号機 Traffic lights

ココにも
FUJIMI

サファイア基板を
磨く過程で COMPOL
が使われています。

COMPOL is used for
manufacturing process
of sapphire substrates
placed in LED lamps.



ココにも FUJIMI スマートフォン Smartphones

部品の中の水晶振動子
製造過程で GC が使われ
ています。

GC is used for manufacturing
process of crystal oscillators
placed in smartphones.

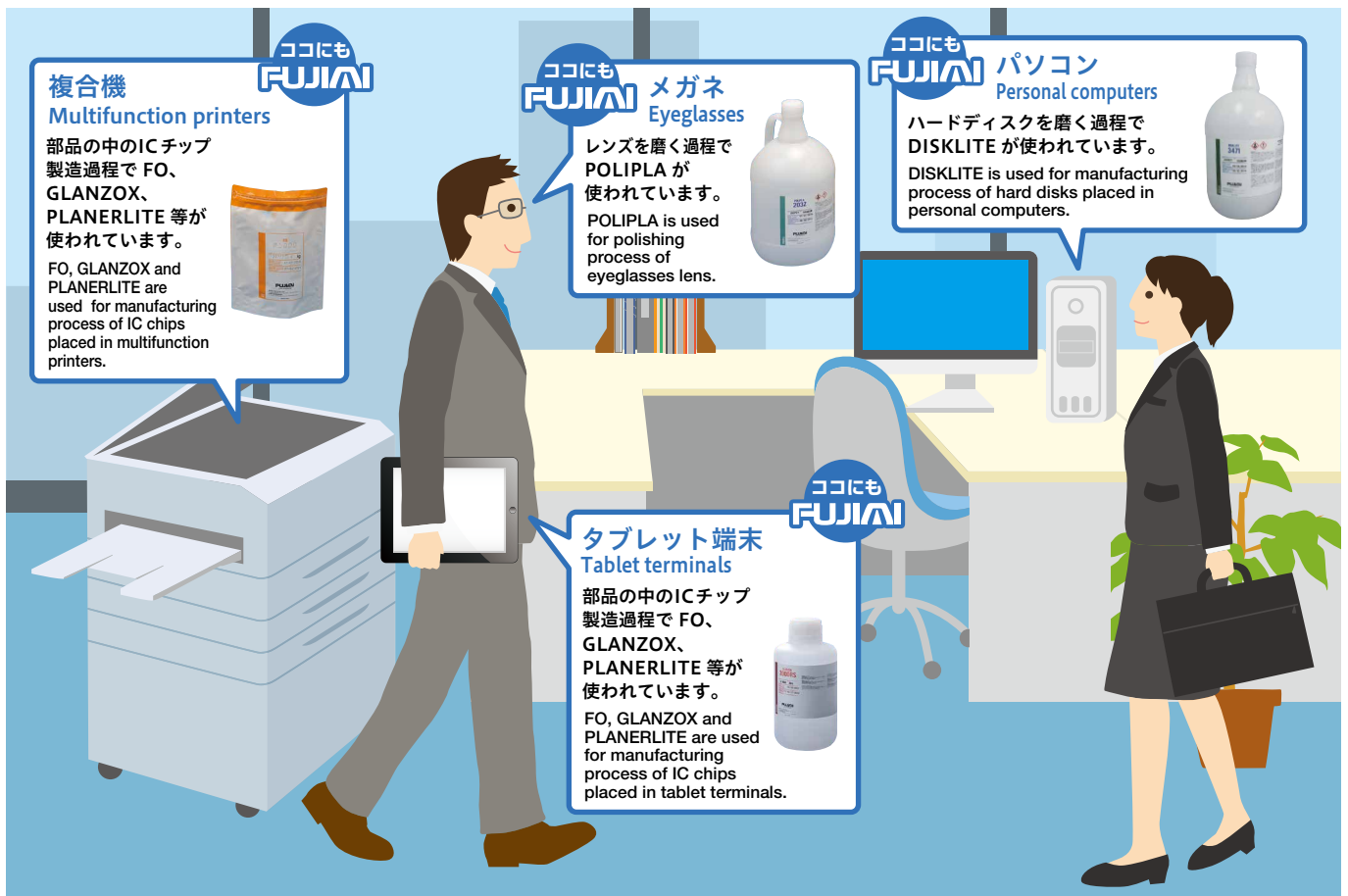


ココにも FUJIMI 自動車 Automobiles

ボディを磨くのに
GC、WA が使われています。

GC and WA are used for
polishing process of
automobile bodies.





複合機
Multifunction printers

部品の中のICチップ製造過程でFO、GLANZOX、PLANERLITE等が使われています。
FO, GLANZOX and PLANERLITE are used for manufacturing process of IC chips placed in multifunction printers.



ココにも
FUJIAI

メガネ
Eyeglasses

レンズを磨く過程でPOLIPLAが使われています。
POLIPLA is used for polishing process of eyeglasses lens.



ココにも
FUJIAI

パソコン
Personal computers

ハードディスクを磨く過程でDISKLITEが使われています。
DISKLITE is used for manufacturing process of hard disks placed in personal computers.



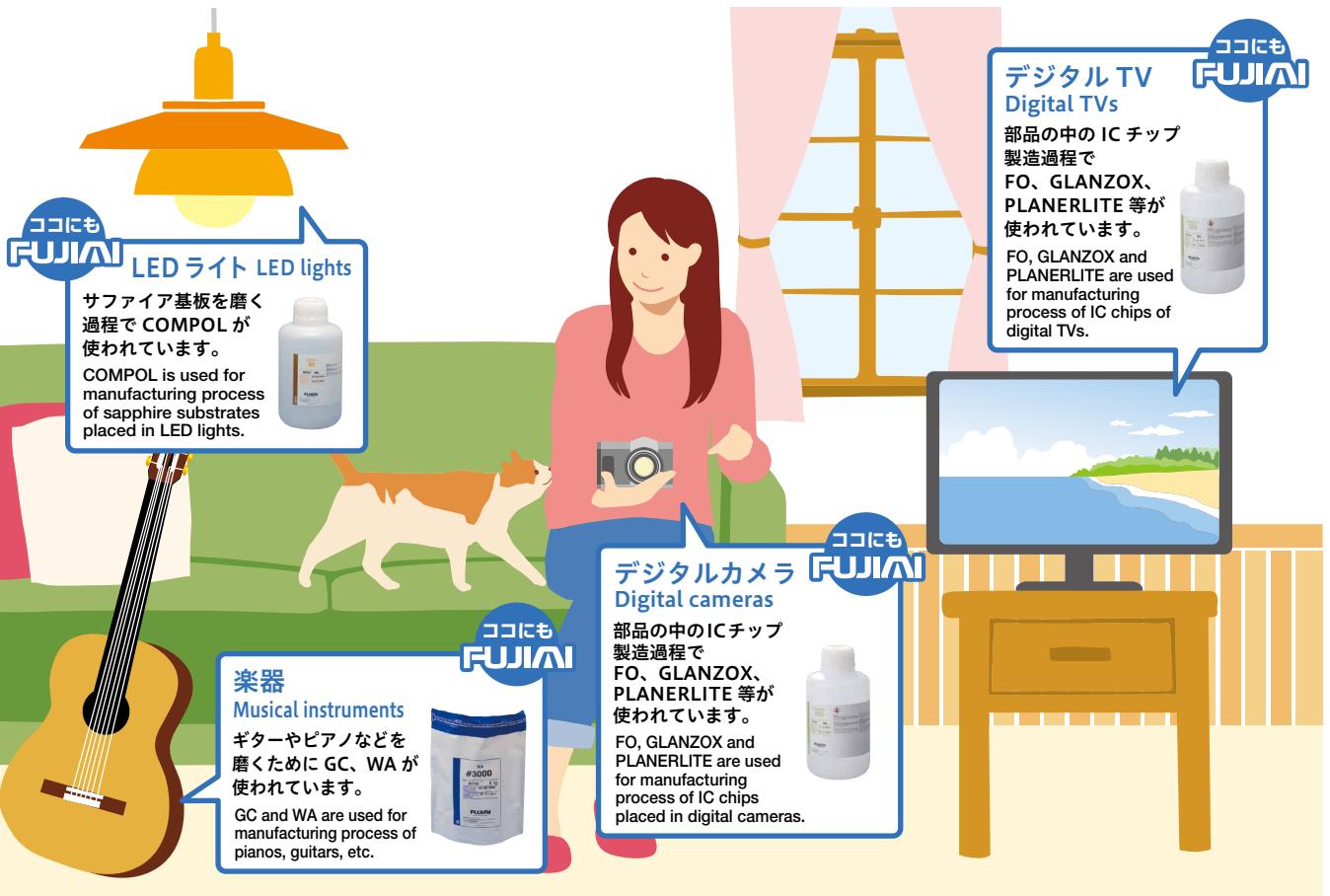
ココにも
FUJIAI

タブレット端末
Tablet terminals

部品の中のICチップ製造過程でFO、GLANZOX、PLANERLITE等が使われています。
FO, GLANZOX and PLANERLITE are used for manufacturing process of IC chips placed in tablet terminals.



ココにも
FUJIAI



LEDライト
LED lights

サファイア基板を磨く過程でCOMPOLが使われています。
COMPOL is used for manufacturing process of sapphire substrates placed in LED lights.



ココにも
FUJIAI

デジタルTV
Digital TVs

部品の中のICチップ製造過程でFO、GLANZOX、PLANERLITE等が使われています。
FO, GLANZOX and PLANERLITE are used for manufacturing process of IC chips of digital TVs.



ココにも
FUJIAI

デジタルカメラ
Digital cameras

部品の中のICチップ製造過程でFO、GLANZOX、PLANERLITE等が使われています。
FO, GLANZOX and PLANERLITE are used for manufacturing process of IC chips placed in digital cameras.



ココにも
FUJIAI

楽器
Musical instruments

ギターやピアノなどを磨くためにGC、WAが使われています。
GC and WA are used for manufacturing process of pianos, guitars, etc.



ココにも
FUJIAI

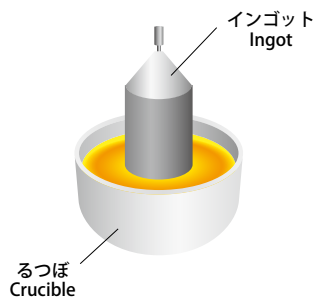
製造工程の中のフジミ

Fujimi's Products in Manufacturing Process

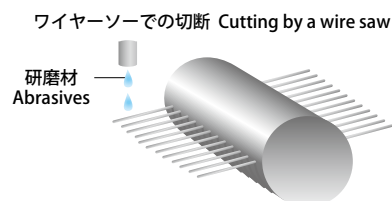
半導体デバイス製造に使われるフジミの製品

Fujimi's products used for semiconductor device production

インゴット引き上げ Crystal Pulling



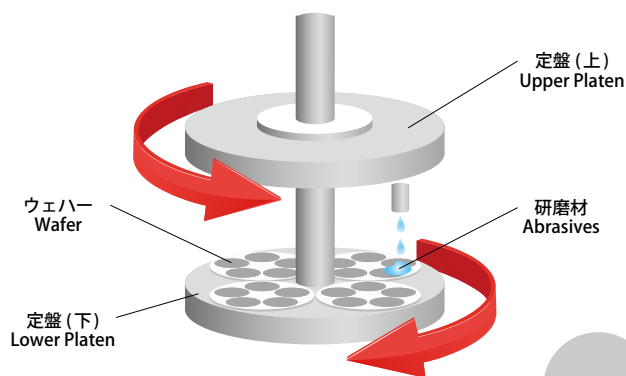
シリコンインゴットの切断 Cutting the silicon ingot



フジミの研磨材はココで使われます。
Fujimi's abrasives are used here.

単結晶シリコンインゴットを
ウェハーにスライスします。
Single crystal silicon ingot
is sliced into wafers.

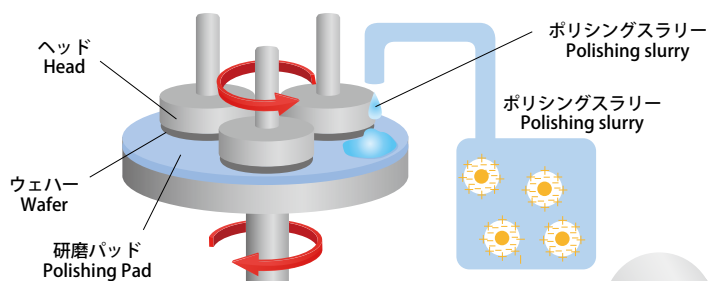
ラッピング工程 Lapping Process



フジミの研磨材はココで使われます。
Fujimi's abrasives are used here.

シリコンウェハー表面の粗さを整えます。
Surface roughness of silicon wafers
are reduced.

ポリシング工程 Polishing Process

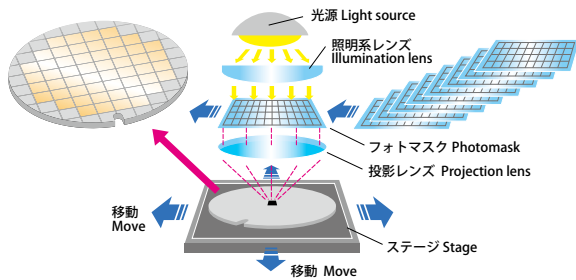


フジミの研磨材はココで使われます。
Fujimi's abrasives are used here.

シリコンウェハー表面を鏡面状に磨き上げます。
Wafers surfaces are mirror-polished.

※イラストはイメージです。
 実際の工程とは異なることもあります。
 The illustrations are only example images.
 The actual process may vary from the illustrations.

フォトリソグラフィ工程 Photolithography Process

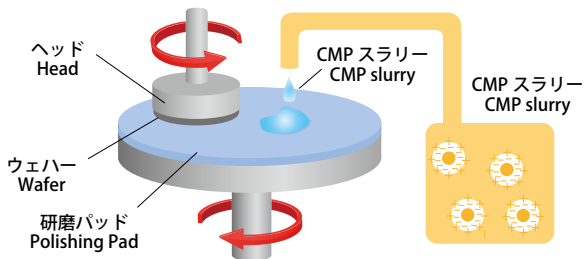


フォトレジスト（感光剤）をウェハー表面に塗布し、回路パターンが描かれたフォトマスクをウェハーに焼きつけます。その後、不要な酸化膜やレジストをエッチングして取り除くとパターンの完成です。
 Photosensitizing agent is applied to the wafer surface and the circuit pattern-printed photomask is baked onto the wafer. Afterwards, oxide film and resist are removed by etching to complete the pattern.

繰り返し Repetition

CMP工程 CMP Process

スラリーを流しながら、ヘッドに保持されたウェハーの表面を、研磨テーブル表面の研磨パッドに接触させて研磨します。
 While slurry is being poured, the surface of the wafer, which is fixed to the head, is polished by contacting it with the polishing pad mounted on the surface of a polishing table.

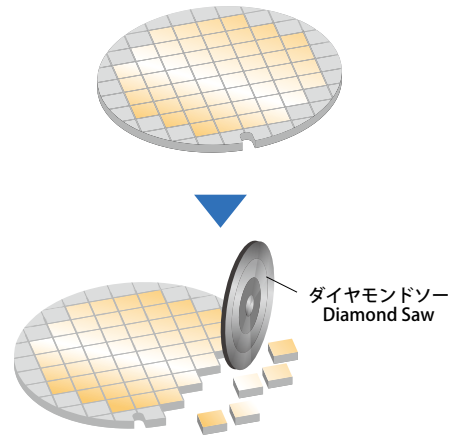


フジミの研磨材はココで使われます。
 Fujimi's abrasives are used here.

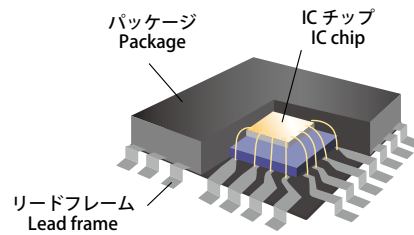
堆積された膜の凹凸をCMPによって平坦化します。
 The irregularities of accumulated films are flattened in the CMP process.

組み立て Assembling

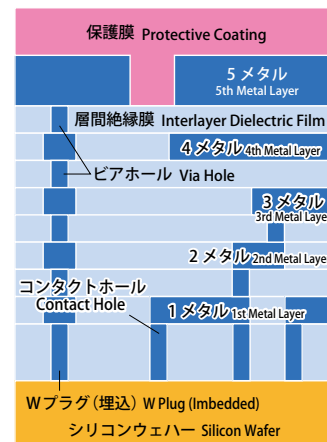
デバイスウェハー Patterned wafer



ダイヤモンドソーでウェハーを縦横にカット
 The diamond saw slices a wafer into pieces.

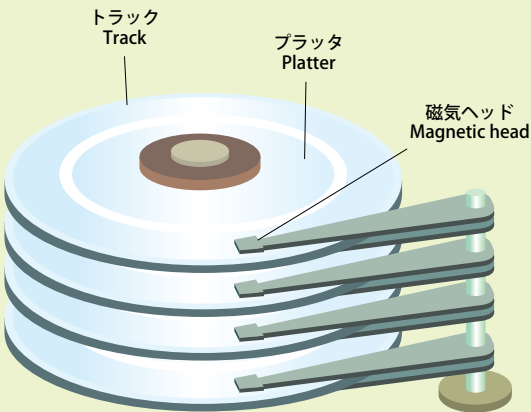
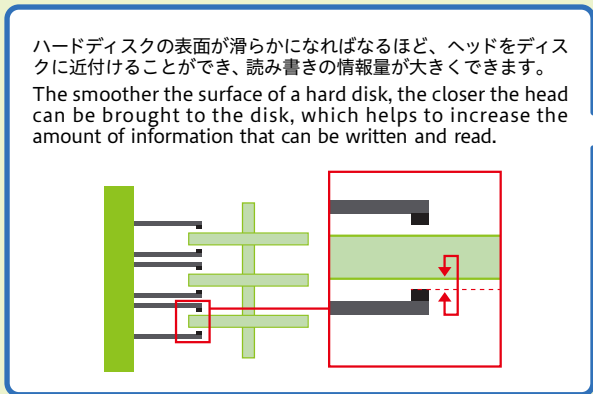
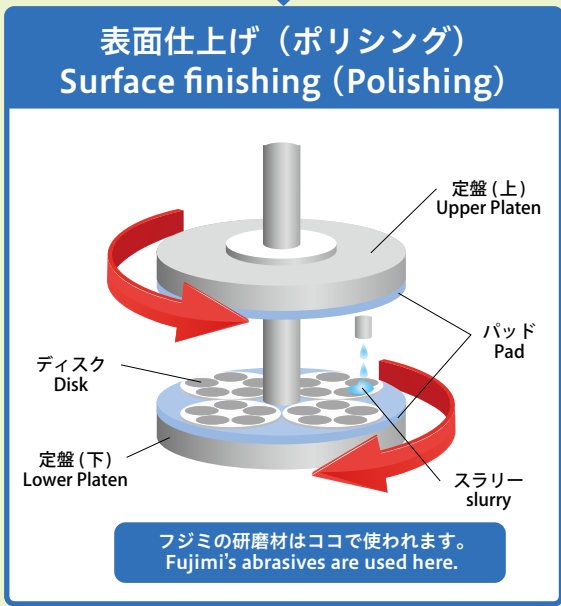
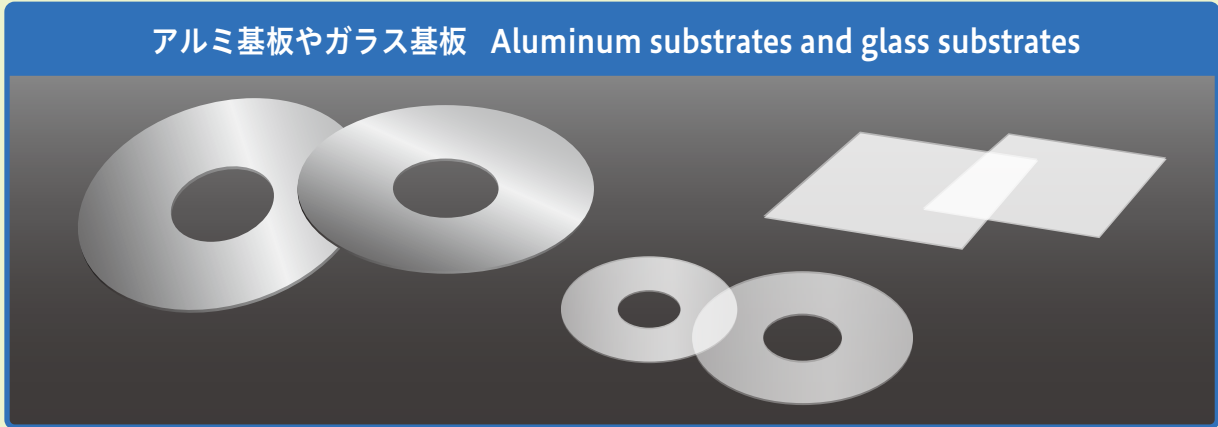


ウェハーをチップに切り分け、パッケージングして出荷します。
 The wafer is cut into pieces and shipped after packaging.



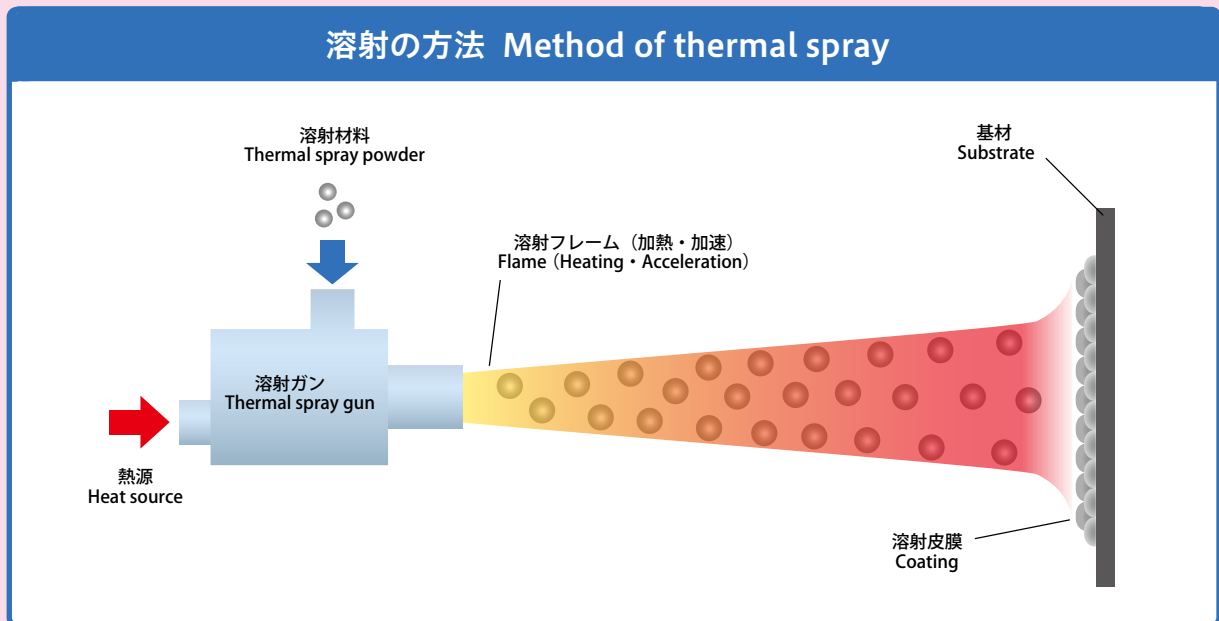
この工程を12~14回繰り返し、多層配線を形成します。
 This process is repeated 12 to 14 times to form multi-layer interconnections.

ハードディスクの構造 Structure of hard disks

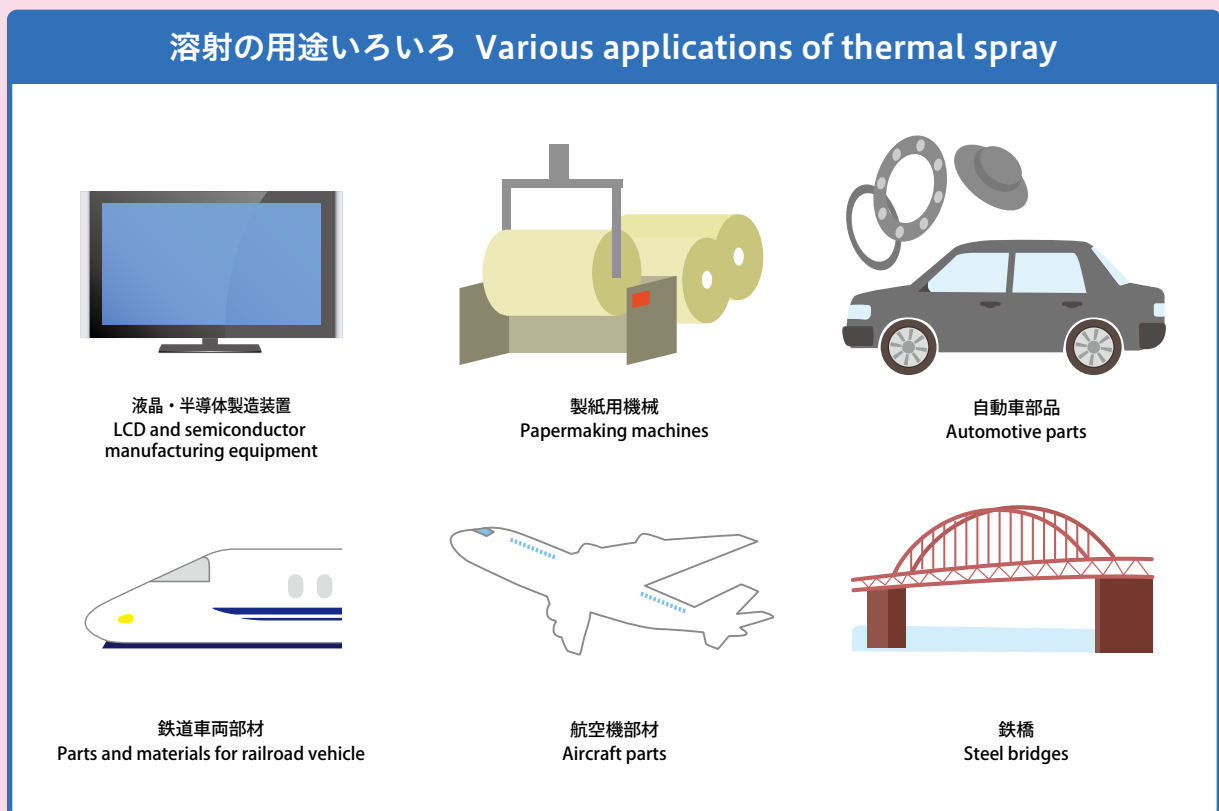


溶射といろいろな用途

Thermal spray and various applications



溶射材料を溶射フレイムに投入し、基材へ衝突、堆積させることで機能性皮膜を作製する。
Thermal spray powder is supplied into the flame, then deposited on the substrate to form functional coatings.



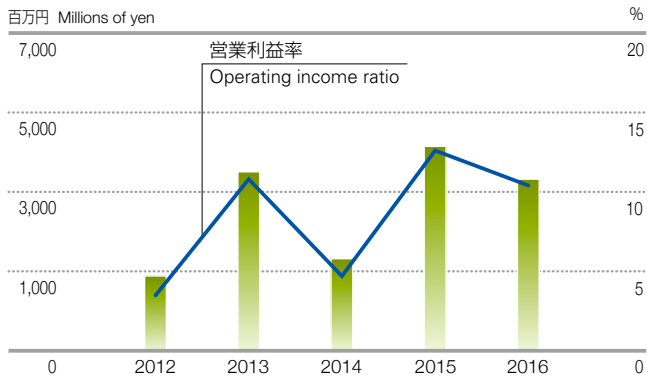
過酷な条件下で使用される機械部品や構造物を熱や腐食、摩耗から守り、長持ちさせる目的で使われる溶射材。その用途は、鉄道や液晶・半導体製造装置や発電に利用されるガスタービン、製紙用機械や鉄橋など多岐にわたっています。
Thermal spray is used to protect machine parts and structures that are used under extreme conditions against heat, corrosion, and abrasion, and to make them durable. Thermal spray is applied to a variety of fields including railroads, LCD and semiconductor manufacturing equipment, gas turbines for power generation, papermaking machines and steel bridges.

経営指標 Selected Financial Data

収益性 Profitability

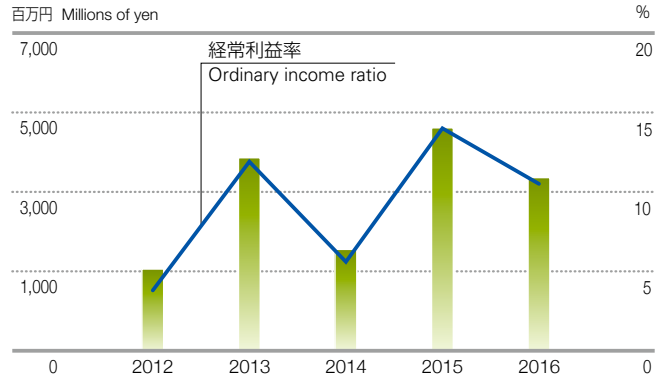
営業利益/営業利益率

Operating Income and Operating Income Ratio



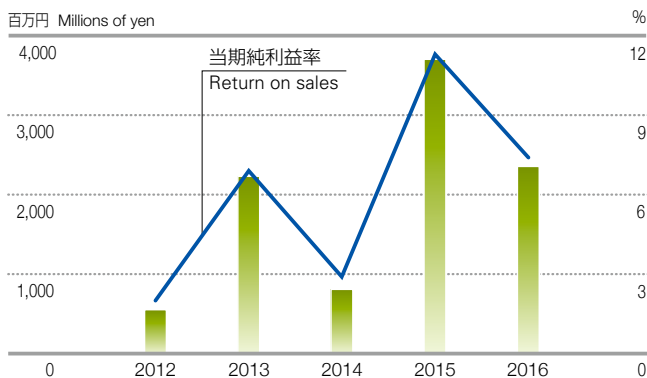
経常利益/経常利益率

Ordinary Income and Ordinary Income Ratio



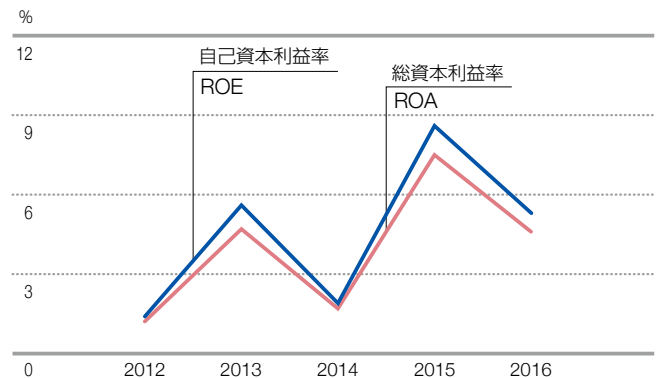
親会社株主に帰属する当期純利益/当期純利益率

Net Income and Return on Sales



自己資本利益率/総資本利益率

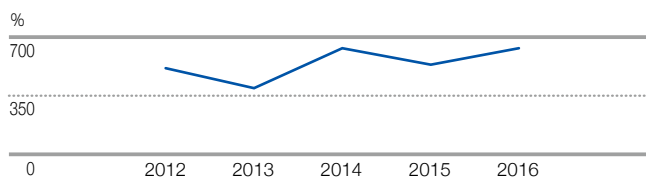
Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA)



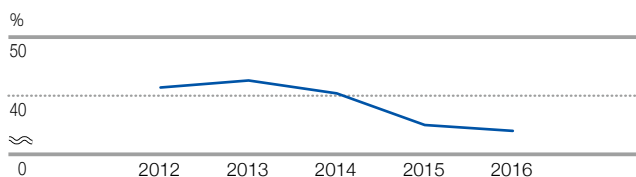
Fiscal years ended March 31				平成24年 3月期	平成25年 3月期	平成26年 3月期	平成27年 3月期	平成28年 3月期
				2012	2013	2014	2015	2016
売上高	百万円	Net sales	Millions of yen	27,424	32,412	27,492	32,815	31,755
営業利益	百万円	Operating income	Millions of yen	953	3,496	1,300	4,128	3,302
営業利益率	%	Operating income ratio	%	3.5	10.8	4.7	12.6	10.4
経常利益	百万円	Ordinary income	Millions of yen	1,038	3,843	1,535	4,596	3,342
経常利益率	%	Ordinary income ratio	%	3.8	11.9	5.6	14.0	10.5
親会社株主に帰属する当期純利益	百万円	Net income	Millions of yen	543	2,222	799	3,695	2,346
当期純利益率	%	Return on sales	%	2.0	6.9	2.9	11.3	7.4
自己資本利益率 (ROE)	%	Return on equity	%	1.4	5.6	1.9	8.6	5.3
総資本利益率 (ROA)	%	Return on assets	%	1.2	4.7	1.7	7.5	4.6

安定性 Stability

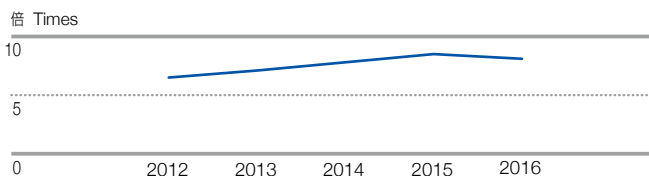
流動比率 Current Ratio



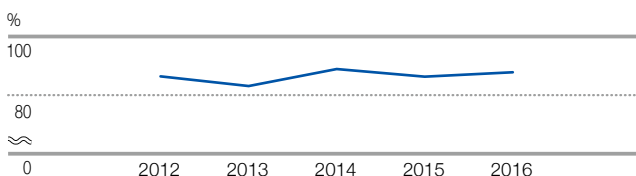
固定比率 Non-current Assets Ratio



手元流動性比率 Short-Term Liquidity



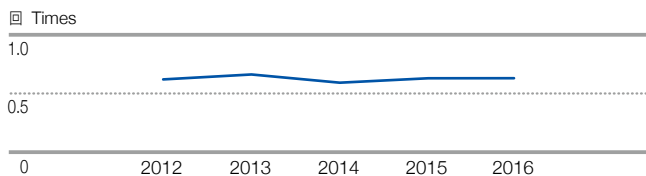
自己資本比率 Equity Ratio



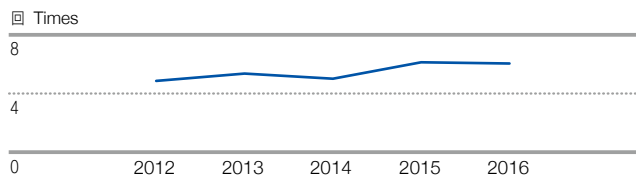
Fiscal years ended March 31				平成24年 3月期 2012	平成25年 3月期 2013	平成26年 3月期 2014	平成27年 3月期 2015	平成28年 3月期 2016
流動比率	%	Current ratio	%	516.1	395.1	634.3	535.3	633.7
固定比率	%	Non-current assets ratio	%	41.4	42.6	40.4	35.0	34.0
手元流動性比率	倍	Short-term liquidity	Times	6.5	7.1	7.8	8.5	8.1
自己資本比率	%	Equity ratio	%	86.4	83.1	88.9	86.3	87.8

生産性 / 効率性 Productivity and Efficiency

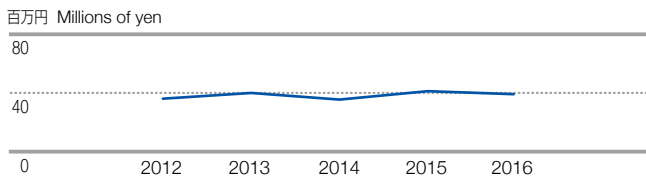
総資本回転率 Total Asset Turnover



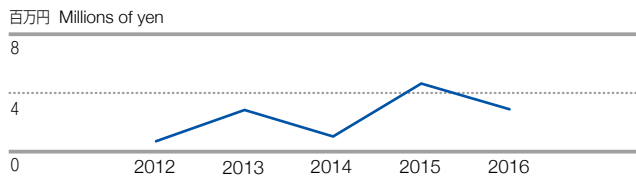
たな卸資産回転率 Inventory Turnover



従業員1人当たり売上高 Net Sales per Employee



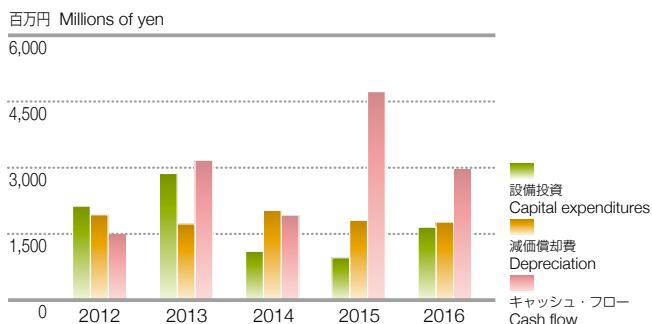
従業員1人当たり当期純利益 Net Income per Employee



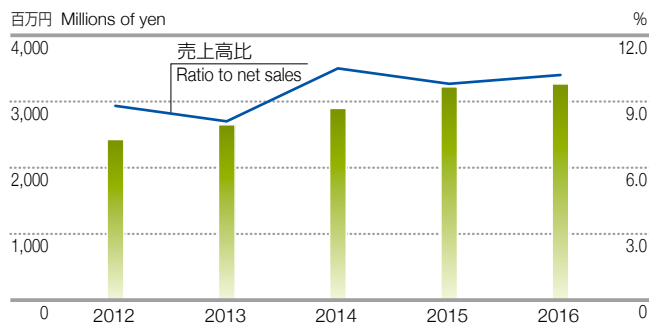
Fiscal years ended March 31				平成24年 3月期 2012	平成25年 3月期 2013	平成26年 3月期 2014	平成27年 3月期 2015	平成28年 3月期 2016
総資本回転率	回	Total asset turnover	Times	0.62	0.66	0.59	0.63	0.63
たな卸資産回転率	回	Inventory turnover	Times	4.86	5.36	5.01	6.13	6.05
従業員1人当たり売上高	百万円	Net sales per employee	Millions of yen	36.08	41.39	35.47	41.12	39.16
従業員1人当たり当期純利益	百万円	Net income per employee	Millions of yen	0.71	2.84	1.03	4.63	2.89
従業員数	人	Number of employees		760	783	775	798	811

設備投資 / 研究開発 Capital Expenditures / Research and Development

設備投資/減価償却費/キャッシュ・フロー Capital Expenditures, Depreciation and Cash Flow



研究開発費/売上高比 R&D Expenses and Ratio to Net Sales



Fiscal years ended March 31				平成24年 3月期	平成25年 3月期	平成26年 3月期	平成27年 3月期	平成28年 3月期
				2012	2013	2014	2015	2016
設備投資	百万円	Capital expenditures	Millions of yen	2,116	2,856	1,094	947	1,637
減価償却費	百万円	Depreciation	Millions of yen	1,921	1,713	2,022	1,794	1,754
キャッシュ・フロー * 1	百万円	Cash flow	Millions of yen	1,492	3,157	1,913	4,712	2,960
研究開発費	百万円	R&D expenses	Millions of yen	2,415	2,638	2,885	3,210	3,254
売上高比	%	Ratio to net sales	%	8.8	8.1	10.5	9.8	10.2

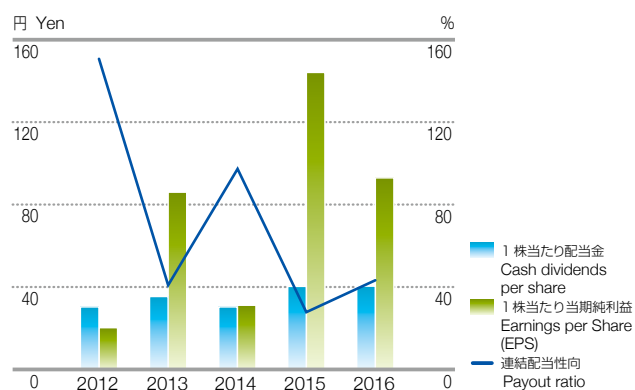
* 1 キャッシュ・フロー = 当期純利益 + 減価償却費 - 配当金

Note: Cash flow = Net income + Depreciation - Dividends

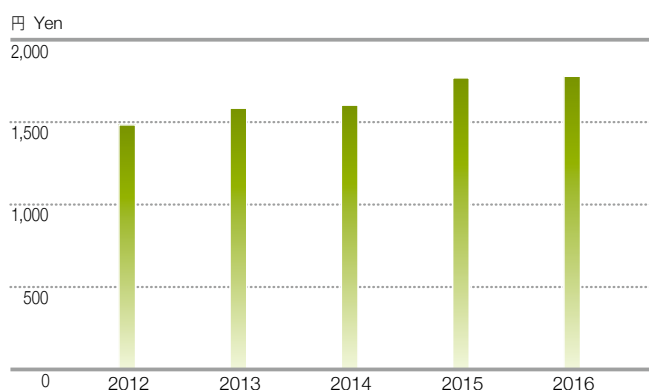
投資指標 Per Share Data and Others

1株当たり配当金/連結配当性向 Cash Dividends per Share, Payout Ratio

1株当たり当期純利益 Earnings per Share (EPS)

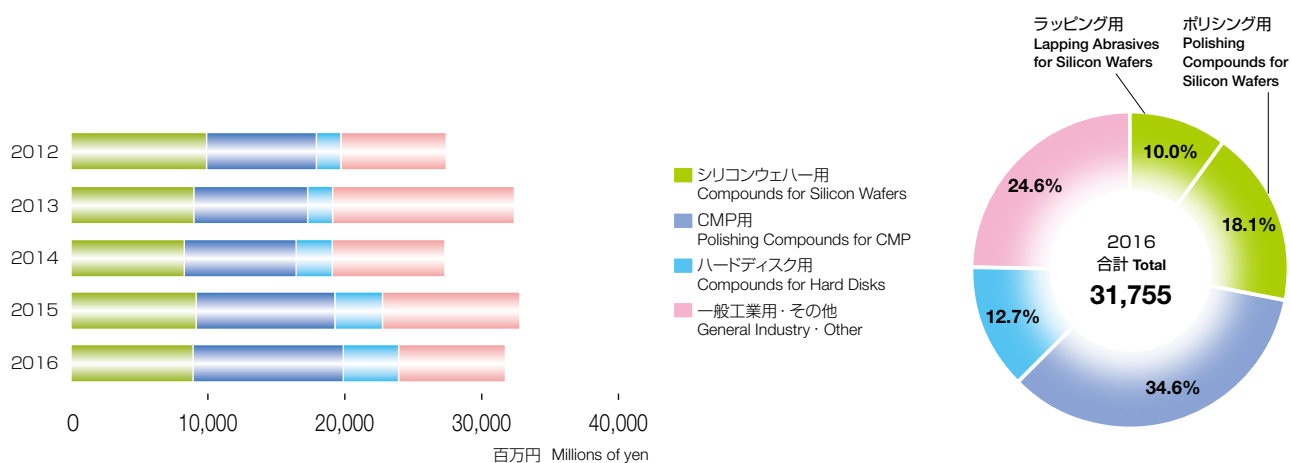


1株当たり純資産 Book Value per Share (BPS)



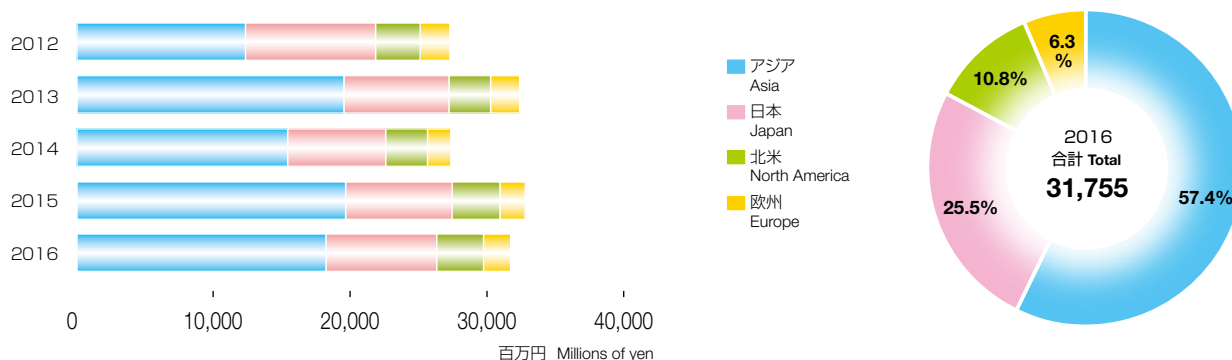
Fiscal years ended March 31				平成24年 3月期	平成25年 3月期	平成26年 3月期	平成27年 3月期	平成28年 3月期
				2012	2013	2014	2015	2016
1株あたり配当金	円	Cash dividends per share	Yen	30.00	35.00	30.00	40.00	40.00
連結配当性向	%	Payout ratio	%	150.7	40.9	97.3	27.8	43.2
1株当たり当期純利益 (EPS)	円	Earnings per share	Yen	19.91	85.68	30.82	143.79	92.63
1株当たり純資産 (BPS)	円	Book value per share	Yen	1,478.56	1,579.79	1,598.32	1,763.88	1,774.30

用途別製品売上高 Sales by Application



Fiscal years ended March 31		平成24年 3月期	平成25年 3月期	平成26年 3月期	平成27年 3月期	平成28年 3月期
百万円 Millions of yen		2012	2013	2014	2015	2016
シリコンウェハー用	Compounds for Silicon Wafers	9,907	8,973	8,330	9,148	8,925
CMP用	Polishing Compounds for CMP	8,029	8,323	8,224	10,143	10,980
ハードディスク用	Compounds for Hard Disks	1,788	1,826	2,658	3,478	4,041
一般工業用・その他	General Industry・Other	7,698	13,288	8,280	10,044	7,809
合計	Total	27,424	32,412	27,492	32,815	31,755

地域別売上高 Sales by Region



Fiscal years ended March 31		平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期
百万円 Millions of yen		2012	2013	2014	2015	2016
アジア	Asia	12,389	19,542	15,490	19,667	18,228
日本	Japan	9,568	7,696	7,208	7,799	8,106
北米	North America	3,282	3,046	3,075	3,500	3,431
欧州	Europe	2,183	2,127	1,718	1,848	1,989
合計	Total	27,424	32,412	27,492	32,815	31,755

連結貸借対照表

Consolidated Balance Sheet

百万円 Millions of yen

		As of March 31				
		平成24年 3月期 2012	平成25年 3月期 2013	平成26年 3月期 2014	平成27年 3月期 2015	平成28年 3月期 2016
資産の部	Assets					
流動資産	Current assets					
現金及び預金	Cash and deposits	9,490	14,023	12,709	18,390	19,320
受取手形及び売掛金	Notes and accounts receivable	6,504	6,021	5,780	6,487	6,669
有価証券	Securities	5,301	5,109	5,106	4,805	1,999
たな卸資産	Inventories	6,241	5,856	5,107	5,606	5,383
繰延税金資産	Deferred tax assets	434	610	393	690	448
その他	Other current assets	574	285	825	182	1,713
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	(41)	(31)	(25)	(28)	(11)
流動資産合計	Total current assets	28,506	31,877	29,898	36,134	35,525
固定資産	Non-current assets					
有形固定資産	Property, plant and equipment					
建物及び構築物（純額）	Buildings and structures(Net base)	6,782	8,197	7,779	7,913	7,341
機械装置及び運搬具（純額）	Machinery equipment and vehicles(Net base)	2,062	2,130	1,665	1,384	1,027
土地	Land	3,392	3,402	3,410	3,425	3,418
建設仮勘定	Construction in progress	818	204	167	120	809
その他	Other property, plant and equipment	914	1,511	1,547	1,302	1,081
有形固定資産合計	Total property, plant and equipment	13,970	15,445	14,570	14,146	13,680
無形固定資産	Intangible assets	462	608	593	710	686
投資その他の資産	Investments and other assets					
投資有価証券	Investment securities	99	115	126	247	525
繰延税金資産	Deferred tax assets	48	18	176	154	164
その他	Other investments and other assets	1,493	1,470	1,515	522	112
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	(199)	(198)	(232)	(124)	(9)
投資その他の資産合計	Total investments and other assets	1,442	1,406	1,586	799	793
固定資産合計	Total non-current assets	15,875	17,460	16,750	15,656	15,159
資産合計	Total assets	44,381	49,337	46,648	51,790	50,684

		平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
		3月期	3月期	3月期	3月期	3月期
As of March 31		2012	2013	2014	2015	2016
負債の部	Liabilities					
流動負債	Current liabilities					
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payable	3,082	3,173	2,713	3,319	2,703
短期借入金	Short-term loans payable	41	—	—	—	—
未払法人税等	Income taxes payable	14	1,605	56	763	263
賞与引当金	Provision for bonuses	612	679	554	947	785
その他	Other current liabilities	1,773	2,610	1,389	1,719	1,853
流動負債合計	Total current liabilities	5,523	8,068	4,713	6,750	5,605
固定負債	Non-current liabilities					
繰延税金負債	Deferred tax liabilities	33	31	13	13	8
退職給付引当金	Provision for retirement benefits	147	172	—	—	—
退職給付に係る負債	Net defined benefit liability	—	—	389	311	526
その他	Other non-current liabilities	32	34	23	20	19
固定負債合計	Total non-current liabilities	214	238	427	345	554
負債合計	Total liabilities	5,737	8,307	5,140	7,096	6,160
純資産の部	Net assets					
株主資本	Shareholders' equity					
資本金	Capital stock	4,753	4,753	4,753	4,753	4,753
資本剰余金	Capital surplus	5,069	5,069	5,069	5,038	5,038
利益剰余金	Retained earnings	35,716	37,160	37,052	38,836	40,042
自己株式	Treasury shares	(5,711)	(5,711)	(5,711)	(5,379)	(5,725)
株主資本合計	Total shareholders' equity	39,828	41,272	41,163	43,248	44,109
その他の包括利益累計額	Accumulated other comprehensive income	(1,475)	(294)	295	1,446	414
新株予約権	Subscription rights to shares	59	52	48	—	—
非支配株主持分	Non-controlling interests	231	—	—	—	—
純資産合計	Total net assets	38,643	41,030	41,507	44,694	44,523
負債純資産合計	Total liabilities and net assets	44,381	49,337	46,648	51,790	50,684

連結損益計算書

Consolidated Statement of Income

百万円 Millions of yen

		Fiscal years ended March 31				
		平成24年 3月期 2012	平成25年 3月期 2013	平成26年 3月期 2014	平成27年 3月期 2015	平成28年 3月期 2016
売上高	Net sales	27,424	32,412	27,492	32,815	31,755
売上原価	Cost of sales	19,399	21,116	18,262	19,887	19,353
売上総利益	Gross profit	8,024	11,295	9,230	12,927	12,402
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	7,070	7,798	7,929	8,799	9,099
営業利益	Operating income	953	3,496	1,300	4,128	3,302
営業外収益	Non-operating income					
受取利息	Interest income	60	70	62	46	28
その他	Other non-operating income	75	326	215	459	68
営業外収益合計	Total of non-operating income	136	396	277	506	97
営業外費用	Non-operating expenses					
支払利息	Interest expenses	5	0	—	0	—
その他	Other non-operating expenses	46	49	42	39	58
営業外費用合計	Total of non-operating expenses	51	50	42	39	58
経常利益	Ordinary income	1,038	3,843	1,535	4,596	3,342
特別利益	Extraordinary income	6	6	3	48	—
特別損失	Extraordinary losses	63	—	253	—	—
税金等調整前当期純利益	Profit before income taxes	980	3,849	1,285	4,645	3,342
法人税、住民税及び事業税	Income taxes—current	157	1,754	384	1,287	733
法人税等調整額	Income taxes—deferred	260	(152)	100	(338)	262
当期純利益	Profit	562	2,247	799	3,695	2,346
非支配株主に帰属する当期純利益	Profit attributable to non-controlling interests	19	25	—	—	—
親会社株主に帰属する当期純利益	Profit attributable to owners of parent	543	2,222	799	3,695	2,346

連結包括利益計算書

Statement of Consolidated Comprehensive Income

百万円 Millions of yen

		Fiscal years ended March 31				
		平成24年 3月期 2012	平成25年 3月期 2013	平成26年 3月期 2014	平成27年 3月期 2015	平成28年 3月期 2016
当期純利益	Profit	562	2,247	799	3,695	2,346
その他の包括利益	Other comprehensive income					
その他有価証券評価差額金	Valuation difference on available-for-sale securities	2	11	2	85	(11)
為替換算調整勘定	Foreign currency translation adjustment	(88)	1,204	680	1,048	(920)
退職給付に係る調整額	Remeasurements of defined benefit plans, net of tax	—	—	—	17	(100)
その他の包括利益合計	Total other comprehensive income	(85)	1,216	682	1,151	(1,031)
包括利益	Comprehensive income	476	3,464	1,482	4,846	1,314
(内訳)	Breakdown					
親会社株主に係る包括利益	Comprehensive income attributable to owners of parent	462	3,403	1,482	4,846	1,314
非支配株主に係る包括利益	Comprehensive income attributable to non-controlling interests	14	60	—	—	—

連結キャッシュ・フロー計算書

Consolidated Statement of Cash Flows

百万円 Millions of yen

		Fiscal years ended March 31				
		平成24年 3月期 2012	平成25年 3月期 2013	平成26年 3月期 2014	平成27年 3月期 2015	平成28年 3月期 2016
営業活動によるキャッシュ・フロー		Cash flows from operating activities				
税金等調整前当期純利益	Profit before income taxes	980	3,849	1,285	4,645	3,342
減価償却費	Depreciation	1,921	1,713	2,022	1,794	1,754
減損損失	Impairment loss	—	—	253	—	—
売上債権増減額（増加）	Decrease (increase) in notes and accounts receivable	130	697	394	(495)	(421)
仕入債務増減額（減少）	Increase (decrease) in notes and accounts payable	26	(89)	(608)	442	(421)
たな卸資産増減額（増加）	Decrease (increase) in inventories	(1,161)	644	945	(281)	23
その他	Other	98	591	(813)	332	14
小計	Subtotal	1,996	7,407	3,479	6,438	4,291
利息及び配当金の受取額	Interest and dividend income received	64	66	77	57	38
利息の支払額	Interest expenses paid	(5)	(0)	—	(0)	—
法人税等の支払額	Income taxes paid	(892)	(233)	(2,512)	(644)	(1,519)
法人税等の還付額	Income taxes refund	—	345	—	641	59
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by operating activities	1,162	7,585	1,044	6,491	2,869
投資活動によるキャッシュ・フロー		Cash flows from investing activities				
定期預金の預入による支出	Payments into time deposits	(2,615)	(3,017)	(2,223)	(3,719)	—
定期預金の払戻による収入	Proceeds from withdrawal of time deposits	2,508	2,912	2,517	3,993	2,969
有価証券の取得による支出	Purchase of securities	(800)	(3,106)	(4,107)	(2,800)	(2,999)
有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of securities	—	1,300	4,100	3,602	3,300
有形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment	(1,707)	(2,370)	(1,597)	(722)	(990)
その他	Other	(262)	(622)	(139)	(31)	(655)
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) investing activities	(2,876)	(4,904)	(1,450)	322	1,623
財務活動によるキャッシュ・フロー		Cash flows from financing activities				
長期借入金の返済による支出	Repayments of long-term loans payable	(79)	(41)	—	—	—
配当金の支払額	Cash dividends paid	(971)	(778)	(907)	(778)	(1,140)
その他	Other	(1,929)	(7)	(8)	(909)	(1,504)
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by financing activities	(2,980)	(827)	(916)	(1,687)	(2,644)
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents	(146)	576	303	309	(453)
現金及び現金同等物の増加（減少）額	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	(4,841)	2,429	(1,019)	5,436	1,394
現金及び現金同等物期首残高	Cash and cash equivalents at beginning of period	16,265	11,579	14,009	12,990	18,426
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額	Increase in cash/cash-equivalent resulting from changes in the accounting period of affiliated	155	—	—	—	—
現金及び現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents at end of period	11,579	14,009	12,990	18,426	19,820

会社データ

Corporate Data

商号 Name	株式会社フジミインコーポレーテッド FUJIMI INCORPORATED
設立年月日 Date of establishment	1953年(昭和28年)3月20日 March 20, 1953
資本金 Paid-in capital	¥4,753,438,500
上場市場 Securities traded	東京証券取引所第一部 Tokyo Stock Exchange (First Section) 名古屋証券取引所第一部 Nagoya Stock Exchange (First Section) 証券コード 5384 Code 5384
従業員数 Number of employees	811 (単体 Non-Consolidated 559)

役員 Board of Directors

2016年(平成28年)6月22日現在 (As of June 22, 2016)

代表取締役社長 President	関 敬史 Keishi Seki
常務取締役 Director	伊藤 広一 Hirokazu Ito
取締役 Director	鈴木 彰 Akira Suzuki
取締役 Director	大脇 寿樹 Toshiki Owaki
取締役 Director	鈴木 勝弘 Katsuhiko Suzuki
取締役 Director	川下 政美* Masami Kawashita
常勤監査役 Standing Corporate Auditor	松島 伸男 Nobuo Matsushima
常勤監査役 Standing Corporate Auditor	藤川 佳明 Yoshiaki Fujikawa
監査役 Corporate Auditor	高橋 正彦** Masahiko Takahashi
監査役 Corporate Auditor	岡野 勝** Masaru Okano

(*印は社外取締役)
(**印は社外監査役)

Note: * indicates outside directors
** indicates outside corporate auditors

沿革 History

日付	内容	Date	Event
1950年(昭和25年)8月	不二見研磨材工業所を創立し、人造精密研磨材の生産を開始	August 1950	Founded Fujimi Abrasives and started production of synthetic precision abrasives.
1953年(昭和28年)3月	不二見研磨材工業株式会社を設立	March 1953	Established Fujimi Abrasives Manufacturing Co., Ltd.
1957年(昭和32年)	東京通信工業(株)(現ソニー(株))のゲルマニウム半導体基盤用研磨材ニーズに対応	1957	Supplied lapping abrasives for germanium semiconductor substrates to Tokyo Tsushin Kogyo, the predecessor of Sony Corporation.
1967年(昭和42年)7月	シリコンウェハー用ポリシング材[GLANZOX]を発表	July 1967	Announced the development of GLANZOX polish for silicon wafers.
1977年(昭和52年)1月	プラスチックレンズ用研磨材[POLIPLA]を生産開始	January 1977	Began manufacturing POLIPLA plastic lens polishing compounds.
1981年(昭和56年)	[COMPOL]シリーズを開発	1981	Developed the "COMPOL" series.
1988年(昭和63年)9月	超高純度のシリコンウェハー用ポリシング材[GLANZOX3900]を開発	September 1988	Developed GLANZOX-3900 as an ultra-high-purity polishing compound for silicon wafers.
1990年(平成2年)11月	ディスク用ポリシング材[DISKLITE]シリーズを開発	November 1990	Developed the DISKLITE series, the first polishing compounds developed especially for memory disks.
1995年(平成7年)4月	CMP用スラリー[PLANERLITE]シリーズを開発	April 1995	Developed the PLANERLITE series of CMP slurries.
2000年(平成12年)12月	CMPスラリー(Cu用)[PLANERLITE-7000]シリーズを開発	December 2000	Developed the PLANERLITE-7000, a new slurry series for Cu CMP.
2001年(平成13年)1月	耐衝撃WCサーメット溶射材[SURPREX W2010X]を発表	January 2001	Introduced the SURPREX-W2010X, new WC cermet thermal spraying composites of enhanced impact resistance.
2002年(平成14年)3月	FUJIMI AMERICA INC.*がインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー(PQS)賞」を受賞	March 2002	FUJIMI AMERICA INC.* won the Preferred Quality Supplier Award from Intel.
2002年(平成14年)10月	世界初、HVOF[高速フレーム溶射]による微粉末溶射システムの確立に成功	October 2002	Successfully developed the world's first ultra-fine-grain thermal spray system employing a high velocity oxy-fuel (HVOF) process.
2003年(平成15年)3月	当社およびFUJIMI AMERICA INC.*がインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー(PQS)賞」を受賞	March 2003	FUJIMI INCORPORATED and FUJIMI AMERICA INC.* received the Preferred Quality Supplier Award from Intel.
2004年(平成16年)3月	FUJIMI CORPORATIONが、インテル社の最高位にランクされる「サプライヤー・コンティニュアス・クオリティ・インプルーブメント(SCQI)賞」を受賞	March 2004	FUJIMI CORPORATION received the Prestigious Supplier Continuous Quality Improvement Award from Intel.
2007年(平成19年)2月	東証一部、名証一部に同時上場	February 2007	Listed Fujimi's shares on the Tokyo Stock Exchange First Section and Nagoya Stock Exchange First Section.
2008年(平成20年)7月	FUJIMI CORPORATIONがAMD社の「World Class Supplier Pathfinder Award 2007」を受賞	July 2008	FUJIMI CORPORATION received the World Class Supplier Pathfinder Award 2007 from AMD.
2009年(平成21年)11月	研磨に適した新しい粒子「角状ナノアルミナ」の開発に成功	November 2009	Successfully developed "angular nano-aluminium" as an abrasive material.
2010年(平成22年)3月	世界初、500℃から成膜可能な超硬溶射材料の開発に成功	March 2010	Successfully developed the world's first tungsten carbide powders applicable to low temperature spray processes of 500°C.
2011年(平成23年)4月	航空・宇宙・防衛 品質マネジメントシステム(JIS Q 9100)認証を取得(溶射材)	April 2011	Obtained JIS Q 9100 quality management certification for aircraft, space and defense (for thermal spray materials).
2013年(平成25年)12月	TSMC社より「Excellent Performance Award(優秀賞)」を受賞	December 2013	FUJIMI INCORPORATED received the Excellent Performance Award from TSMC.
2015年(平成27年)3月	FUJIMI CORPORATIONがインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー(PQS)賞」を受賞	March 2015	FUJIMI CORPORATION received the Preferred Quality Supplier Award from Intel.
2016年(平成28年)3月	FUJIMI CORPORATIONがインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー(PQS)賞」を受賞	March 2016	FUJIMI CORPORATION received the Preferred Quality Supplier Award from Intel.

* FUJIMI AMERICA INC.は 2003(平成15年)7月にFUJIMI CORPORATIONと合併し、商号をFUJIMI CORPORATIONに変更しました。

* FUJIMI AMERICA INC. merged with FUJIMI CORPORATION in 2003 July and changed the business name to FUJIMI CORPORATION.

株式情報 Stock Information

大株主一覧 Leading Shareholders

2016年(平成28年)3月31日現在 (As of March 31, 2016)

株主名 Name of Shareholder		所有株式数 (千株) Number of Shares Owned (Thousands of Shares)	持株比率 (%) Shareholding ratio
株式会社フジミインコーポレーテッド	FUJIMI INCORPORATED (Treasury Stock)	4,605	15.5
越山 勇	Isamu Koshiyama	2,902	9.7
有限会社コマ	Koma Co.,Ltd.	1,638	5.5
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	The Master Trust Bank of Japan, Ltd.(Trust account)	1,278	4.3
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	Japan Trustee Services Bank, Ltd.(Trust account)	1,212	4.0
株式会社三菱東京UFJ銀行	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	728	2.4
株式会社りそな銀行	Resona Bank, Ltd.	691	2.3
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE-HCROO	NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE-HCROO	655	2.2
フジミ取引先持株会	Fujimi suppliers' stock ownership program	641	2.1
日本生命保険相互会社	Nippon Life Insurance Co.	639	2.1

(注) 所有株式数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2位以下を切り捨てしています。

Note: Shareholdings of less than 1,000 shares are omitted. Percentage shareholding is omitted after the second decimal place.

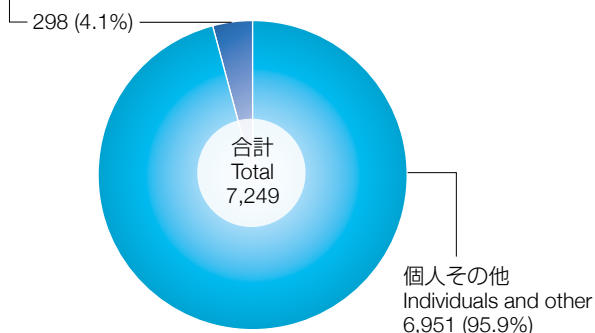
所有者別分布状況 Composition of Shareholders by Category

2016年(平成28年)3月31日現在 (As of March 31, 2016)

所有者別株主数(人) Shareholders by Category (Number of Shareholders)

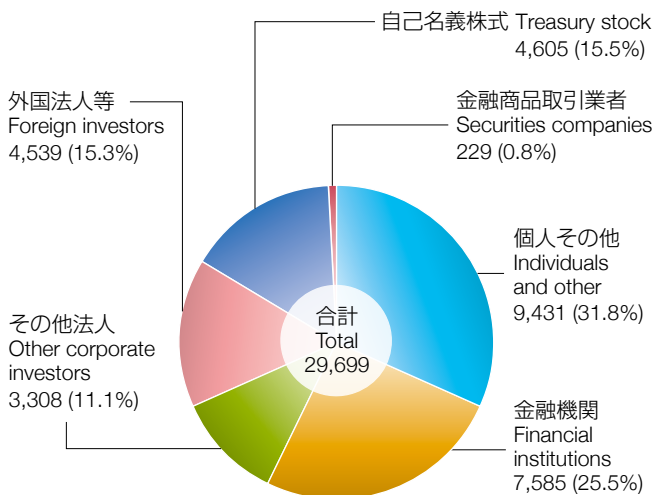
Shareholders by Category (Number of Shareholders)

金融機関 34 (0.5%) Financial institutions	外国法人等 148 (2.0%) Foreign investors
金融商品取引業者 24 (0.3%) Securities companies	自己名義株式 1 (0.0%) Treasury stock
その他法人 91 (1.3%) Other corporate investors	



所有者別持株数(千株) Shares Held by Shareholder Type (Thousands of Shares)

Shares Held by Shareholder Type (Thousands of Shares)



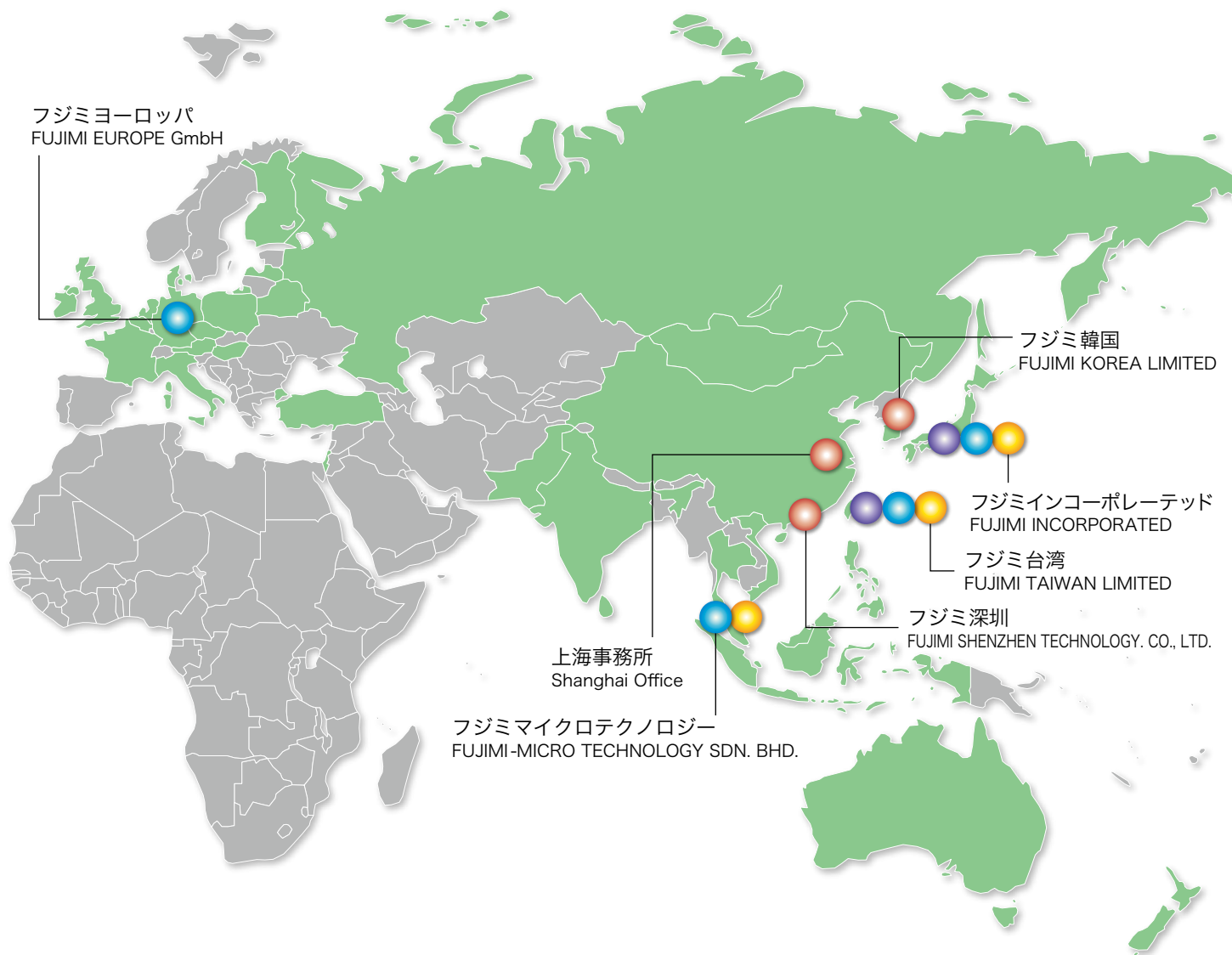
発行済株式の推移 Common Stock Issues

日付 Date	摘要 Type of Issue	発行済株式数(千株) Shares Outstanding (Thousands of Shares)
1992年(平成4年)2月1日 February 1, 1992	第三者割当増資 Allotment of new shares to third parties	245
1992年(平成4年)11月20日 November 20, 1992	1株につき2株の株式分割(無償) 2-for-1 stock split	491
1993年(平成5年)9月27日 September 27, 1993	新株引受権の権利行使 Exercise of warrants	509
1994年(平成6年)5月20日 May 20, 1994	1株につき2株の株式分割(無償) 2-for-1 stock split	1,019
1994年(平成6年)8月4日 August 4, 1994	500円額面株式1株を50円額面株式 10株に分割 Exchange of 10 stocks with par value ¥50 for 1 stock with par value ¥500	10,195
1995年(平成7年)4月18日 April 18, 1995	一般公募増資 Public offering of common stock	10,995
1996年(平成8年)5月20日 May 20, 1996	1株につき1.1株の株式分割(無償) 1.1-for-1 stock split	12,094
1996年(平成8年)10月1日 October 1, 1996	一般公募増資 Public offering of common stock	12,894
1997年(平成9年)5月20日 May 20, 1997	1株につき1.1株の株式分割(無償) 1.1-for-1 stock split	14,184
1998年(平成10年)5月20日 May 20, 1998	1株につき1.1株の株式分割(無償) 1.1-for-1 stock split	15,602
2001年(平成13年)11月22日 November 22, 2001	自己株式の利益消却 Retirement of profits of treasury stock	15,349
2005年(平成17年)5月20日 May 20, 2005	1株につき2株の株式分割(無償) 2-for-1 stock split	30,699
2014年(平成26年)11月4日 November 4, 2014	自己株式の消却 Retirement of treasury stock	29,699

(注) 2016年6月15日付で自己株式の消却1,000,000株を実施しており、消却後の発行済株式数は28,699,500株であります。

Note: The company owns 28,699,500 issued shares after the retirement of 1,000,000 treasury stocks on June 15, 2016.

グローバル展開 Global Expansion



事務所・拠点 Plants and Offices

本社・枇杷島工場 Headquarters · Biwajima Plant
〒452-8502
愛知県清須市西枇杷島町地領 2-1-1
Phone: 052-503-8181 Fax: 052-503-6166
1-1, Chiryō-2, Nishibiwajima-cho, Kiyosu,
Aichi 452-8502, Japan
Phone: +81-52-503-8181 Fax: +81-52-503-6166

稲沢工場 Inazawa Plant
〒492-8329
愛知県稲沢市西島町市助戸 1-1
1-1, Ichisukekoudo, Nishijima-cho, Inazawa,
Aichi 492-8329, Japan

各務原工場 Kakamigahara Plant
〒504-0927
岐阜県各務原市上戸町 7-1-8
1-8, Jyogo-cho-7, Kakamigahara,
Gifu 504-0927, Japan

各務東町工場 Kakamihigashimachi Plant
〒509-0103
岐阜県各務原市各務東町 5-62-1
62-1, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara,
Gifu 509-0103, Japan

溶射材事業部 Thermal Spray Materials Department
〒509-0103
岐阜県各務原市各務東町 5-82-28
82-28, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara,
Gifu 509-0103, Japan

研究開発センター R&D Center
〒509-0109
岐阜県各務原市テクノプラザ 1-8
8, Technoplaza-1, Kakamigahara,
Gifu 509-0109, Japan

先端技術研究所 Advanced Technology Research Center
〒509-0109
岐阜県各務原市テクノプラザ 1-22
22, Technoplaza-1, Kakamigahara,
Gifu 509-0109, Japan

物流センター Logistics Center
〒509-0109
岐阜県各務原市テクノプラザ 4-1
1, Technoplaza-4, Kakamigahara,
Gifu 509-0109, Japan

東京事務所 Tokyo Office
〒101-0047
東京都千代田区内神田 3-2-8
いちご内神田ビル 7F
7th Floor, ICHIGO Uchikanda Bldg., 2-8,
Uchikanda 3-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-0047, Japan

上海事務所 Shanghai Office
上海市浦東区科苑路 88 号、德国中心 317B 室
317B, German Center, 88 Keyuan Road,
Pudong Zhangjiang, Hi-Tech Park, 201203,
Shanghai, China



フジミコーポレーション
FUJIMI CORPORATION

-  開発拠点
Development base
-  販売拠点
Sales offices
-  生産拠点
Production facilities
-  サポートセンター
Support center
-  販売先国
Product sold countries

連結子会社 Consolidated subsidiary

フジミコーポレーション (米国)

FUJIMI CORPORATION

11200 SW Leveton Drive, Tualatin, Oregon 97062, U.S.A.
Phone: +1-503-682-7822 Fax: +1-503-612-9721

フジミマイクロテクノロジー (マレーシア)

FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.

Lot 13, Jalan Hi-Tech 3, Industrial Zone Phase 1
Kulim Hi-Tech Park, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman Malaysia
Phone: +60-4-403-3700 Fax: +60-4-403-3900

フジミヨーロッパ (ドイツ)

FUJIMI EUROPE GmbH

Schlossstrasse 5 D-74653 Ingelfingen, Germany
Phone: +49-7940-939499-0 Fax: +49-7940-939499-20

フジミ台湾 (台湾)

FUJIMI TAIWAN LIMITED

No.10 Tongke 1st Rd., Tongluo Township,
Miaoli County 366, Taiwan (R.O.C.)
Phone: +886-37-987-123 Fax: +886-37-987-567

フジミ韓国 (韓国)

FUJIMI KOREA LIMITED

RM1203 ParkView, Jungja-Dong 6, BunDang-Gu,
Seongnam-Shi, Kyeonggi-Do, Korea
Phone: +82-31-726-3555 Fax: +82-31-726-3556

フジミ深圳 (中国)

FUJIMI SHENZHEN TECHNOLOGY. CO., LTD.

13G-1, South Maple Building, Nanshan District,
Shenzhen 518054, China
Phone: +86-755-2267-5151 Fax: +86-755-2267-5162

FUJIMI

FUJIMI INCORPORATED

株式会社フジミインコーポレーテッド



この印刷物は、環境負荷低減のため古紙パルプを80%使用した環境対応紙と、植物油を使用し、VOCの排出を抑えた環境対応型リサイクルインキ「ベジタブルインキ」を使用しています。

Copyright (C) 2016 Fujimi Incorporated. All rights reserved.
Printed in Japan